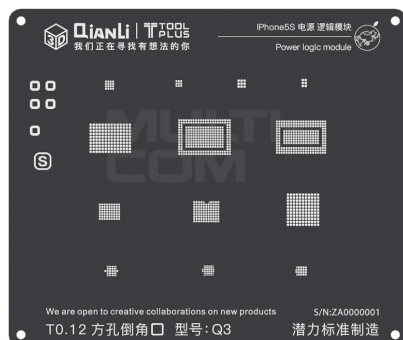


Strona główna > Wyposażenie serwisu > Sprzęt lutowniczy > Sita 3D iBlack > Matryca/sita 3D BGA dla iPhone 5s Power Logic Module Q3- QianLi



Matryca/sita 3D BGA dla iPhone 5s Power Logic Module Q3- QianLi

ID produktu: 22400

Cena netto: **35,77 PLN**

Cena brutto: **44,00 PLN**

Waga: **0,20 kg**

Opis produktu:

Matryca/sita 3D BGA dla iPhone 5s Power Logic Module Q3- QianLi umożliwiają szybszą pracę i wykonywanie precyzyjnego reballingu. Funkcja 3D sit (trójwymiarowa płaskorzeźbę, zaprojektowaną z myślą stabilnego trzymania chipa na miejscu pod szablonem) sprawia, że mocowanie układu jest znacznie łatwiejsze i 100% dokładne. Otwory są wycinane laserowo dzięki temu są precyzyjne i dobrze dopasowane. Dodatkowo czarny kolor ułatwia odróżnienie układu od szablonu, dzięki czemu jest wygodny i łatwy w użyciu a praca technika jest łatwiejsza i bardziej wydajna.

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)

